

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-23

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	银叶投资、朱雀基金、招商资管、交银施罗德基金、山西证券、国泰君安证券
时间	2023年9月21日
地点	深南电路股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面专业从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控医疗等领域。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。</p> <p>公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023年上半年，国内通信市场需求未出现明显改善，海外通信市场需求受到局部地区 5G 建设项目进展延缓影响，公司通信领域订单规模同比略有下降。在市场环境带来的挑战下，公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，并持续加大力度推进新客户开发工作。</p> <p>Q3、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。</p> <p>数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡</p>

献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。2023 年上半年，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第二季度以来，数据中心领域下游部分客户项目库存有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023 年上半年，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占 PCB 整体营收比重有所提升。

Q5、请介绍公司南通三期项目连线后产能爬坡进展。

公司汽车电子 PCB 专业工厂南通三期于 2021 年第四季度连线投产，2022 年底已实现单月盈利，目前产能爬坡进展顺利，产能利用率达到五成以上。

Q6、请介绍公司封装基板业务在下游市场拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域，覆盖了包括半导体垂直整合制造商、半导体设计商及半导体封测商等主要客户群，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。

2023 年上半年，受全球半导体景气持续低迷，下游厂商去库存等因素影响，公司各类封装基板订单较去年同期均出现不同程度下滑。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果，把握了今年第二季度封装基板领域局部出现的需求修复机

会。同时，公司在 FC-BGA 封装基板的技术研发与客户认证方面均取得阶段性进展。

Q7、请介绍公司广州封装基板项目的产品定位及当前建设进展。

公司广州封装基板项目主要面向 FC-BGA 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板三类产品。项目共分两期建设，其中项目一期厂房及配套设施建设和机电安装工程已基本完工，生产设备已陆续进厂安装、调试，预计将于 2023 年第四季度连线投产。

Q8、请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。

公司 FC-BGA 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。

Q9、请介绍公司近期原材料采购价格变化情况。

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，2023 年以来原材料价格整体相对保持稳定。公司将持续关注国际市场铜等大宗商品价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。

Q10、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。

公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节，产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、部分整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心，协同 PCB 业务，发挥公司电子互联产品技术平台优势，通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单

无

日期

2023 年 9 月 21 日